products preview

Laser Tech 2011

会期：2011年9月28日（水）～30日（金）/ 会場：パシフィコ横浜

出展製品特集

ピコ秒パルスレーザ Heliosシリーズ

独イノライト社製のピコ秒パルス、小型空冷、低価格で高出力のDPSSレーザ（INNOLIGHT GmbH）。EO式のQスイッチを搭載しており、パルス幅は約500psと短パルス。ビームモードはM2=1.2以下の高品位ビームで集光性に優れ、パルス幅が短いために高品位な加工が可能。太陽電池のスクライブ加工をはじめ、特に薄膜加工に最適。ナノ秒パルスレーザの価格帯で、ピコ秒レーザと同等の加工品質を達成出来るのが特徴。

年間300台以上の量産体制を確立済みで、品質と信頼性には定評があり、各種振動テストや落下テストも実施済みの産業用レーザ。

（株）オプトピア　営業部
☎044-812-5911
ブース番号：T-33

ビームトラック・サーマルセンサ

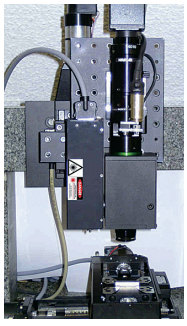
オフィール社のビームトラック・サーマルセンサ（特許取得済み）の登場で、1台のセンサでビーム位置、ビーム径、レーザ出力を1台のパワーメータで測定が可能となった。IRカードやビューアを使用せず、入射位置を容易に再現可能。ビームのゆらぎやビーム径

の変化をモニタリングを実現。出力範囲40mW～150W、ビーム位置測定精度0.1mm、ビーム径測定精度±5%。

モデル50（150）A-BB-26-PPS、F150 A-BB-26-PPS他、複数台ラインナップ。小型、PinFin採用にてコンパクトながら高性能。対応ソフトウェアStaLabは、2011年9月にバージョンアップ予定。

（株）オフィールジャパン　レーザ計測機器営業部　☎048-646-4150
ブース番号：T-01

レーザオートフォーカスシステム



Metrology Sensors GmbH社のレーザオートフォーカスシステムはセミコンダクタ検査、フラットパネル・ディスプレイ検査、太陽電池検査を高速、高精度トラッキングが可能。対象物との距離を常に最適フォーカス位置に保つ機構により、最適なトラッキングが可能。モデルはTTL Point Laser Auto Focus、TTL Line Laser Auto Focus、TTL Chromatic Distance Sensorをラインナップ。

LINE LASWER AUTO FOCUS SYSTEMはCMOSエリアセンサー技術を採用して、高速度、高精度を可能にした。CMOS技術を用いることにより1秒間に250フレームを処理できる。FPGAsとマイクロコントローラを組み合わせることにより処理速度は5 KHzが可能。用途はTFTアレイ、セル・モジュール、のリペアーなど。

㈱キーストンインターナショナル　営業技術部　☎04-7175-8810
ブース番号：T-19

パルスファイバレーザ

住友電工の新製品パルスファイバレーザSumiLasは、ピコ秒に至る広い範囲でパルス幅が可変、高ピークパワー、高ビーム品質などの特長によりさまざまなレーザ加工への適用が可能。光ファイバおよび光通信で培った専門技術を統合し、微細加工プロセスへ高い付加価値、信頼性、サービスを提供する。

（株）住友電気工業　営業企画部 新規事業開発室　☎03-6722-3393
ブース番号：T-27

高性能3軸レーザスキャンシステム

独RAYLASE社のAXIALSCAN-50は、近年需要の高まる銅コートホイル、セラミック分離ホイルの切断などの3軸加工の要望に応えることができる高性能ガルバノスキャンシステム。本製品はRAYLASE社の特許である「Double motor Z axis technology」を採用。この技術により、Z軸レンズを2つのモ

ーターで前後させることによりプロセススピードと精度、双方の向上を実現した。すでにドイツでは導入実績もあり、各国で導入が検討されている最新鋭の製品。Nd：YAG、CO_2レーザ等のハイパワーのパルスレーザと併せてご利用ができる。

(株)オプトサイエンス　営業部
☎03-3356-1064
ブース番号：T-22

ピコ秒発振レーザシステム

Photonics Industries社製ピコ秒発振レーザシステムのモデルRGシリーズは1064nm（IR）波長発振モデルで1kHz時に1パルス6mJという高パルスエネルギーを発振可能でパルスエネルギーが必要な用途に最適。

モデルRGHシリーズは高繰返し発振モデルで最大1MHzまで発振可能なので高速加工用途に適している。

RGLシリーズ、RGHシリーズの中から用途に最適な波長を選択することができる。

レイチャーシステムズ(株)　営業部
☎03-3351-0717
ブース番号：T-17

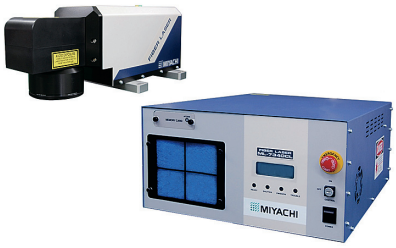
レーザマーキングシステム

デジタルスキャナー搭載微細加工に最適なQMARKシリーズは、一般のガルバノスキャナーでは不可能であった、±1.25um/ppmの絶対位置精度を実現。ステージの位置決め精度に匹敵する、高精度・高速加工システムであ

る。本システムは、Quantronix社の特徴を生かした使用光源(IR、Green、UV、Femto)を選択することにより、ありとあらゆる材料の微細加工に対応できる。制御ソフトには、定評のあるDesign Commanderを採用し、操作性もまた優れたなシステムである。特にマイクロマシンなどのレーザ加工には欠かせない高度な位置精度も備えたレーザ加工機である。
(本システムは、エクセルテクノロジー㈱オリジナル製品で日本国外では販売していない。)

エクセルテクノロジー（株）
カントロニクス事業　☎03-5305-5313
ブース番号：T-05

ファイバレーザ加工機



ML-7320CL、7340CLは、金属部品・樹脂部品などの小型部品への印字マーキングや、SUS材への黒色加工、アルミへの彫刻加工、塗膜の剥離加工やバリ取り加工に最適な完全空冷式ファイバレーザ加工機。ファイバレーザがもつ高いビーム品質は、微細領域でも高精細なマーキング、加工を可能にし、優れたレーザ発振効率により省エネルギー化を実現。

また、高出力20W、40Wファイバレーザ発振器と、パルス波形制御方式を採用し、金属から樹脂まで幅広く、高速・高品質なマーキング、加工が可能。さらに、従来の固体レーザの問題であった、加工条件が変化した場合の印字品質の安定性を大幅に改善し、加工品質の向上に役立つ。制御ソフトは、信頼性の高い最新のソフトウェア「LM Draw6」を搭載。従来機と互換性があり、機種移行もスムーズに対応できる。

ミヤチテクノス(株)　広報・IR部
TEL 03-3847-2567
ブース番号：T-26

成型回路部品レーザ加工装置

マルチヘッド多方向同時レーザ照射を採用し、携帯電話用LDSマルチバンドアンテナなど三次元成型回路部品の生産性向上が図れ、小型化部品の大幅な量産コスト低減を可能にするMID成型回路部品レーザ加工装置。 特長はメカニカル・エレクトロニクスを融合した三次元成型回路部品を高スループットで生産。多方向同時レーザ照射と照射データ最適化で、タクトタイムを大幅に短縮、天然石レーザヘッドベースを採用し、高い繰り返し精度、パレット搬送・着脱用ロボットの組込により、24時間生産自動化に対応。

LPKF Laser&Electronics(株)
☎ 045-650-1622
ブース番号：T-07

ILSJ